

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2021-034

**无锡上机数控股份有限公司**  
**关于使用募集资金向全资子公司提供借款**  
**实施募投项目的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月19日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向弘元新材料（包头）有限公司（以下简称“弘元新材”）提供总额不超过人民币297,622.65万元（含）的借款专项用于“年产8GW单晶硅拉晶生产项目”。

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3607号）文核准，公司本次可非公开发行不超过69,752,700股新股。公司本次实际非公开发行股票22,900,763股，向15名特定投资者非公开发行，每股发行价格为人民币131元，共计募集资金总额为人民币2,999,999,953.00元，扣除本次发行费用人民币23,773,491.28元（不含税），实际募集资金净额为2,976,226,461.72元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000071号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

## 二、募集资金投资项目和本次借款基本情况

根据《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行所募集的资金总额不超过 300,000 万元（含 300,000 万元），扣除发行费用后的净额全部用于“年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目”以及“补充流动资金项目”，具体如下：

序号	募投项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	年产8GW单晶硅拉晶生产项目	28.00亿元	21.00亿元	弘元新材
2	补充流动资金项目	9.00亿元	9.00亿元	—

为保障募投项目的顺利实施以及便于公司的管理，公司拟使用部分募集资金对公司全资子公司弘元新材提供总额不超过人民币 297,622.65 万元（含）的借款专项用于“年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目”，本次借款为无息借款，期限不超过 3 年。根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述相关事宜。

## 三、借款人的基本情况

- 1、名称：弘元新材料（包头）有限公司
- 2、社会信用代码：91150204MA0Q8QY28L
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区新规划区园区南路 1 号
- 5、法定代表人：杨昊
- 6、注册资本：70,000 万元人民币
- 7、成立时间：2019 年 5 月 20 日
- 8、经营范围：半导体材料、石墨材料、碳碳材料、单晶硅棒及硅片、半导体设备、太阳能设备的研发、制造、销售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 9、股权结构：系公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权
- 10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2019年12月31日/ 2019年1-12月（经审计）	2020年9月30日/ 2020年1-9月（未经审计）
总资产	142,953.45	330,533.44
净资产	52,062.34	148,283.07
营业收入	25,270.07	172,466.47
净利润	1,952.57	30,537.04

#### 四、本次借款的目的和对公司的影响

本次使用募集资金对公司全资子公司弘元新材提供借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。弘元新材是公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有绝对控制权，财务风险可控。

#### 五、专项意见说明

##### （一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式未改变募集资金的用途，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情形。

综上，我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。

##### （二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式未改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。

##### （三）保荐机构意见

本保荐机构经核查后认为：

上机数控本次使用募集资金向全资子公司弘元新材料（包头）有限公司提供借款用于募投项目的事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。上机数控本次使用募集资金向全资子公司弘元新材料（包头）有限公司提供借款，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

综上，本保荐机构对上市公司本次使用募集资金向全资子公司弘元新材料（包头）有限公司提供借款用于募投项目的事项无异议。

## 六、备查文件

- （一）《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
- （三）《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《国金证券股份有限公司关于无锡上机数控股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2021年2月20日